

自動真空テープ貼付装置

ATL-200DC

多種多様なウェハなどに対し、気泡が入りにくい安定したテープ貼り付けを行うことができます。

半導体製造においてダイシングテープの貼り付けを行う全自動装置です。

特長

- ウェハとテープ間に気泡が入りにくい真空貼付方式を採用しています。
- 貼り付けの際にローラを使用しない為、ウェハに対する局所的な負荷を軽減できます。
- ウェハ表面(パターン)に接触せず貼り付けることができます。
- 多種多様なウェハなどに対するテープ貼り付けができます。
(MEMSウェハ、TAIKO®ウェハ、セラミック、ガラス、フィルムなど)
- テープ供給にはインライン型プリカット方式※を採用、テープコストの削減ができます。
※:大宮工業社製

活用例

- 半導体製造各工程内での貼り付け／貼り合わせ
 - ダイシング工程(ダイシングテープ)
 - 裏面研削工程(バックグラインドテープ)
 - メッキ工程(保護テープ)
 - テープ転写工程(テープ)
 - サポート基板(ウェハ貼り合せ)



エコシンボル
このマークはNECの定める環境配慮基準を
満たした商品に表示されるものです。
この基準の詳細はNECのホームページを
ご覧ください。
<http://www.nec.co.jp/eco/ja/ecopro>

ATL-200DC

製品概要

仕様（型番:ATL-200DC）

ウェハサイズ	4、5、6、8インチ ※1、※2
ウェハカセット	4、5、6、8インチ用ウェハカセット ※1、※2
フレームサイズ	6、8インチ ※1、※2
フレームカセット	6、8インチ用フレームカセット ※1、※2
装置寸法	1600mm(W)×1700mm(D) ×1800mm(H)
質量	約1,200kg
真空用力	-70kPa以下
圧縮空気	0.5MPa以上
電源電圧	三相AC200±5% 30A 50Hz/60Hz

オプション

N2(窒素)パージ機能	低酸素状態で貼り付けを行うことでUV照射後の硬化ムラを抑制します
ウェハアライメント機能	ウェハのオリフラ位置を合わせてウェハ供給を行います

※1:SEMIスタンダード準拠
※2:1サイズ選択となります

※12インチ対応はご相談ください
※その他 特殊仕様にも対応致します

真空テープ貼付装置ラインアップ（半自動機）

VTL-100
真空テープ貼付装置



VTL-201
真空テープ貼付装置



VTL-300
加熱真空テープ貼付装置



安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の使用上の注意事項をよくお読みのうえ正しくお使いください。水、湿気、油等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

人と地球にやさしい情報社会へ

お問い合わせは、下記へ

NEC 社会システム事業本部 エンジニアリング事業推進センター
〒183-8501 東京都府中市日新町一丁目10
TEL:042(333)1510 FAX:042(333)1855

NECエンジニアリング 営業本部
〒140-0002 東京都品川区東品川4-10-27(住友不動産品川ビル7F)
TEL:03(6713)1200 FAX:03(6713)1965

●TAIKOは株式会社ディスコの登録商標です。●本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本製品(ソフトウェア含む)が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、日本国外に持ち出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。
●本紙に掲載された仕様・外観などは、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。